

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 3月2日(月) 10:00~16:00

会場 機械振興会館地下3階研修1号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 配線・実装技術と関連材料技術

1. [招待講演] 単一分子の特性評価を目指したMEMSのバイオ応用 ○久米村百子・藤田博之(東大)
2. [招待講演] めっき銅薄膜配線マイグレーション耐性に及ぼす微細組織の影響
○鈴木 研・加藤武瑠・三浦英生(東北大)
3. [招待講演] チップ間光配線に向けた高密度・アサーマルシリコン光インターポーザ
○中村隆宏・賣野 豊(光電子融合基盤技研)・荒川泰彦(東大)
4. [招待講演] エピタキシャル金属/ゲルマニウム接合の形成による界面電気伝導特性の制御
○中塚 理・鄧 云生・鈴木陽洋・坂下満男・田岡紀之・財満鎮明(名大)

午後

5. [招待講演] 双方向遷移モデルを用いた垂直磁化型STT-MRAMにおける熱安定性の面積依存性評価
○角田浩司・青木正樹・能代英之・射場義久・吉田親子・山崎裕一・高橋 厚・畑田明良・中林正明・杉井寿博(超低電圧デバイス技術研究組合)
6. [招待講演] インターカレーションによる低抵抗多層グラフェン配線の実現
○近藤大雄(産総研/富士通研)・中野美尚・周 波・井 亜希子(産総研)・林 賢二郎(産総研/富士通研)・高橋 誠(産総研)・佐藤信太郎・横山直樹(産総研/富士通研)
7. [招待講演] 性能スケーラビリティと機能フレキシビリティを実現する三次元FPGAのためのインテグレーション技術 ○武田健一・青木真由(日立)
8. [招待講演] CVD/ALDを用いたCu(Mn)/Co(W)配線システムの構築と3次元アトムプローブによるサブナノ構造・バリエーション評価
○嶋 紘平(東大)・ツ ユアン・韓 斌・高見澤 悠(東北大)・清水秀治(東大)・清水康雄(東北大)・百瀬健(東大)・井上耕治・永井康介(東北大)・霜垣幸浩(東大)
9. [招待講演] 選択成長を用いたCNTビアのインテグレーション
磯林厚伸・和田 真・伊東 伴・斎藤達朗・西出大亮・石倉太志・片桐雅之・山崎雄一・松本貴士・北村政幸・渡邊勝仁・佐久間尚志・○梶田明広・酒井忠司(超低電圧デバイス技術研究組合)

◆応用物理学会共催

【問合先】

黒田理人(東北大)

TEL [022] 795-4833, FAX [022] 795-4834

E-mail: kuroda@fff.niche.tohoku.ac.jp